



În perioada 13-16 septembrie 2022 a avut loc la Sibiu a noua ediție a Conferinței de Tehnologie de Integrare a Sistemelor Electronice (**ESTC 2022**). **ESTC** este una dintre cele trei conferințe premium din domeniul semiconductor packaging din întreaga lume și un eveniment internațional de prim rang în domeniul packaging-ului electronic și al integrării sistemelor. Organizată o dată la doi ani, este conferința emblematică a **IEEE EPS** (Electronics Packaging Society of IEEE) din Europa, susținută de IEEE EPS în asociere cu **IMAPS Europe**, și un grup de doi organizatori locali: Universitatea Politehnica București (UPB), **Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN)** și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu.

Cu aproximativ 115 de prezentări orale în peste 20 de sesiuni tehnice, 10 keynote speakers, 7 ateliere de lucru, 4 cursuri de dezvoltare profesională (PDC), 33 de expozați din industrie, și o vizită la sponsorul principal al ESTC 2022, Continental Automotive Systems România, organizatorii au atras peste 350 de participanți din 30 de țări.

Printre participanții de marcă la conferință se numără președinta IEEE Electronics Packaging Society, Kitty Pearsall, președinta IMAPS North America, Beth Keser, respectiv președintele IMAPS Europe, Daniel Nilsen Wright.

În deschiderea conferinței, s-a organizat primul IEEE EPS & NTC (Electronics Packaging Society & Nanotechnology Council) Summit, la care au participat studenți din 9 SBC-uri, din România, Ungaria și Bulgaria.

Domeniile de interes din acest an ale conferinței au fost: Advanced Packaging, Materials for Interconnects and Packaging; Reliability of Electronic Devices and Systems; Power Electronics System Packaging, Optoelectronic System Packaging; Assembly and Manufacturing Technologies; RF, mm-wave, and TH Systems Packaging; Flexible, Printed and Hybrid Electronics; Advanced Technologies for Emerging Systems; Design Tools and Modelling; Biomedical Application Packaging; Global Education for Electronics.

Ținând cont de nivelul științific al conferinței și de modul de organizare a acesteia, membrii comitetului au fost recompensați cu o diplomă de recunoaștere a meritelor, acordată de președinta IEEE Electronics Packaging Society, Kitty Pearsall.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost reprezentată, prin intermediul **Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației**, atât la nivel de comitet de organizare, cât și la nivel de prezentări de lucrări și moderări de sesiuni tehnice.

Prof.dr.ing. Ovidiu A. POP
ESTC2022 Executive Chair
Chair of IEEE EPS&NTC SBC Summit

